

Mrozoodporna cementowa zaprawa klejąca

# PCI Pericol® Standard

do chłonnych okładzin ceramicznych

**PCI**®  
Für Bau-Profis



## Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian i posadzek.
- Do wyklejania chłonnych (o nasiąkliwości min. 3% wg normy PN-EN 14411) okładzin ceramicznych: glazury, terakoty, kamionki, mozaiki ceramicznej, klinkieru, płytek ceglanych itp. na nieodkształcalnych podłożach, jak np.: beton monolityczny, tynki cementowe, wapienno-cementowe, wapienne i gipsowe, jastrychy i wylewki cementowe i anhydrytowe, lastriko oraz stabilne płyty kartonowo-gipsowe i cementowo-włóknowe.
- Także do klejenia niewrażliwych na przebarwienia chłonnych płytek kamiennych.
- Do wyrównującego szpachlowania podłoży mineralnych w zakresie grubości 1 do 5 mm.
- W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.

## Właściwości produktu

- Odpowiada klasie C1TE wg normy PN-EN 12004.
- Brak spływu na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia.
- Długi czas otwarty – większy komfort pracy, zwłaszcza na dużych powierzchniach.
- Mrozo- i wodoodporna.
- Do warstw o grubości: 1 do 5 mm.

<b>CE</b> 1020, 1390	
<b>BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o . K Májovu 1244 537 01 Chrudim</b>	
15 CZ0003/02 PCI Pericol® Standard (CZ0003/02) EN 12004:2007+A1:2012 Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Do ścian i posadzek. EN 12004 C1TE	
Reakcja na ogień	Klasa A1/ A1 <sub>n</sub>
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Substancje niebezpieczne	zgodnie z kartą charakterystyki

Spełnia wymagania  
PN-EN 12004  
**C1TE**

## Dane techniczne

Baza materiałowa	sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i dodatków
Składniki	produkt 1-składnikowy
Gęstość nasypowa	ok. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Gęstość świeżej zaprawy	ok. 1,65 kg/dm <sup>3</sup>
Konsystencja	plastyczna
Kolor	szary
Trwałość składowania	12 miesięcy
Składowanie	w miejscu suchym, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30°C
Opakowanie	wzmocniony worek 25 kg z wkładem polietylenowym
Zużycie:*	
- paca zębata 4 mm	ok. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
- paca zębata 6 mm	ok. 3,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>
- paca zębata 8-10 mm	ok. 4,0-6,0 kg/m <sup>2</sup>
- na m <sup>2</sup> i mm grubości warstwy	ok. 1,2 kg
Temperatura aplikacji i podłoża	+5°C do +25°C
Ilość wody zarobowej:	woda pitna lub woda zgodna z PN-EN 1008
- na 1 kg suchej mieszanki	ok. 0,26 l
- na worek 25 kg	ok. 6,5 l
Czas dojrzewania	ok. 3 minuty
Czas użycia**	ok. 90 minut
Czas otwarty klejenia**	ok. 30 minut
Czasy utwardzania:**	
- możliwość wchodzenia	po ok. 24 godzinach
- możliwość spoinowania	po ok. 24 godzinach
- pełne obciążenie	po ok. 14 dniach
Grubość warstwy kleju	od 1 do 5 mm
Odporność termiczna	-30°C do +80°C
Spływ	≤ 0,5 mm
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	klasa A1/A1 <sub>fl</sub>

\* Na zużycie PCI Pericol® Standard wpływa wielkość i struktura tylnej strony zastosowanej okładziny oraz stopień wyrównania podłoża. W praktyce zużycie może wykazywać odchylenie od podanych wartości.

\*\* Przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

## Przygotowanie podłoża

- Minimalny wiek podłoża:
  - jastrych PCI Novoment® M1 plus: ok. 24 godziny;
  - jastrych PCI Novoment® Z3: ok. 3 dni;
  - tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni;
  - tradycyjne tynki cementowe: ok. 28 dni;
  - beton: ok. 3 miesiące.
- Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- Do wyrównywania posadzek zaleca się użycie masy poziomującej PCI Pericem®. Do równania ścian i sufitów można użyć mas szpachlowych PCI Pericret®, PCI Pericem® Tixo, PCI Nanocret® R2, PCI Nanocret® FC lub PCI Barrafill® 305.
- Silnie chłonne podłoża cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® w rozcieńczeniu 1:1 lub 1:2 z wodą albo PCI Gisogrund® OP w rozcieńczeniu 1:1 z wodą. Podłoża gipsowe zagruntować nie rozcieńczonym środkiem PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® OP.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność szczątkowa, mierzona metodą

CM, powinna wynosić dla:

- podłoży cementowych: 4%;
- dla podłoży gipsowych: 0,5%.

## Sposób użycia

### Przygotowanie zaprawy klejowej

- 1 Wlać do czystego naczynia odpowiednią ilość wody zarobowej. Wsypać zawartość opakowania i wymieszać odpowiednim mieszadłem (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej zaprawy.
- 2 Odczekać ok. 3 minuty i powtórnie

krótco wymieszać.

### Wyklejanie okładzin

- 3 Najpierw gładką stroną pacy rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową.
- 4 Następnie odpowiednią pacą zębatą nanieść (możliwie w jednym kierunku) na świeżą warstwę kontaktową

zaprawę klejową. Nanosić tylko tyle zaprawy, ile można obłożyć płytkami w czasie otwartym klejenia. Opuszkami palca kontrolować czas naskórkowania zaprawy.

- 5 Lekko posuwistym ruchem ułożyć płytki na zaprawie klejowej, docisnąć i ustawić we właściwym położeniu.

## Spoinowanie

- Do wypełnienia spoin użyć odpowiednich zapraw spoinowych, np. PCI Pericolor® Flex, PCI Nanofug®,

PCI Nonofug® Premium czy PCI Durapox® NT plus.

- Spoiny dylatacyjne wypełnić

właściwymi uszczelniaczami, np. PCI Silcofug® E lub PCI Elritan® 100.

## Zalecenia i uwagi

- Do wyklejania płytek o chłonności < 3% wg normy PN-EN 14411 oraz w miejscach narażonych na znaczne zmiany temperatury (ogrzewania podłogowe i ścienne, tarasy, balkony, elewacje), a także na podłożach odkształcalnych zaleca się stosowanie odpowiednich zapraw klejowych PCI klasy C2.
- W przypadku wyklejania kamieni naturalnych wrażliwych

na odkształcenia i przebarwienia należy używać dedykowanych do tego zapraw klejowych PCI Carrament® lub PCI Carraflex®.

- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać ze świeżą zaprawą.
- Nie dodawać do zaprawy klejowej żadnych substancji poza czystą wodą zarobową.
- Jeśli nie ma innych wymagań, należy

zapewnić podklejenie zaprawą klejową min. 65% powierzchni płytki.

- Przed spoinowaniem usunąć spoiny między płytek jeszcze w stanie świeżym resztki zaprawy klejowej.
- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu, gdyż później może być konieczne czyszczenie mechaniczne.

## Wskazówki BHP

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać

pyłu. Zanieczyszczone oczy przeemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice

ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Chronić przed dziećmi.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

## Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



### **Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:**

BASF Polska Sp. z o.o.  
Dział Chemii Budowlanej  
ul. Wiosenna 12  
PL 63-100 Śrem  
telefon 61 636 63 00  
faks 61 636 63 14  
[www.pci-polska.pl](http://www.pci-polska.pl)

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wydanie niniejsze traci aktualność z ukazaniem się nowego wydania karty technicznej.  
Wydanie grudzień 2015.